

深圳清溢光电股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

为贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 27 日披露了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，并于 2024 年 8 月 30 日披露了《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。2024 年度，公司根据“提质增效重回报”行动方案内容积极开展并落实相关工作，在保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了较好成效。

2025 年，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，特制定《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。

公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况及 2025 年度“提质增效重回报”行动方案具体内容如下：

一、聚焦公司核心业务，实现高质量发展

2024 年，公司平板显示行业掩膜版和半导体芯片行业掩膜版业务“双翼”并进，产销规模进一步扩大，营业收入稳步增长。2024 年，公司实现营业收入 111,224.96 万元，同比增长 20.35%；归属于母公司股东的净利润为 17,201.26 万元，同比增长 28.49%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 15,271.27 万元，同比增长 35.61%。净资产为 148,320.67 万元，基本每股收益为 0.65 元。

1、平板显示掩膜版业务

2024 年，公司平板显示掩膜版的营业收入为 8.59 亿元，较上年同期增长 17.59%，公司平板显示掩膜版营业收入增加的主要原因是：子公司合肥清溢光电有限公司平板显示行业掩膜版业务产销规模继续爬升，凭借充足的产能和稳定的质量从客户端争取到更多高规产品的订单。

2024 年，公司 AMOLED/LTPS 的营业收入达到 3.61 亿元人民币，较上年同

期增长 21.75%。目前，公司 AMOLED/LTPS 掩膜版已广泛应用到下游 AMOLED 和 LTPS 显示面板的产品上，包括平板电脑、手机、笔记本、手表、智能驾驶等产品。

公司已实现 8.6 代高精度 TFT 用掩膜版、6 代中高精度 AMOLED/LTPS 等掩膜版，以及中高端半透膜掩膜版(HTM)产品的研发与量产。公司加快技术创新步伐，夯实核心能力，积极布局先进的高规格半透膜掩膜版(HTM)与高规格相移掩膜版(PSM)技术，这两项技术将成为未来高端掩膜版的核心技术，这两项技术的量产将加速高端掩膜版产品的国产替代。同时，公司通过质量体系完善、推行智能制造等方式提升市场竞争力。

2、半导体芯片掩膜版业务

2024 年，公司半导体芯片掩膜版的营业收入为 1.93 亿元，较上年同期增长 33.98%，半导体芯片掩膜版收入增速高于公司整体收入增速，主要原因是：公司半导体业务新增设备产能释放，以及客户开发成果逐步落地。

在 IC Foundry 产品线中，功率器件业务呈现快速增长态势，同时半导体芯片掩膜版技术研发持续取得突破，产品性能达到行业同类产品先进水平。在 IC Bumping 产品线中，先进封装掩膜版业务呈现快速增长态势。

2024 年，公司通过提高半导体芯片掩膜版产品的技术能力及产能，优化半导体芯片掩膜版的产品结构，以及提升细分市场占有率等举措，来推动半导体芯片掩膜版业务的发展。公司将抓住半导体芯片掩膜版国产替代机遇，在重点客户拓展方面取得突破。公司已实现 180nm 工艺节点半导体芯片掩膜版的量产，以及 150nm 工艺节点半导体芯片掩膜版的小规模量产，正在推进 130nm-65nm 的 PSM 和 OPC 工艺的掩膜版开发和 28nm 半导体芯片所需的掩膜版工艺开发规划。

2025 年，公司将加快产能扩张，并提升现有产能利用率。合肥清溢计划引进平板显示用掩膜版光刻机，佛山清溢将于 2025 年投产，将继续扩充高端平板显示用掩膜版的产能；深圳清溢微积极提升半导体芯片用掩膜版的精度及扩充后工序产能，持续提高半导体芯片用掩膜版的产能，佛山清溢微新增设备将陆续到场。

2025 年，公司将在产品和技术方面进一步完善，加大资源研发高端产品，提升高端产品收入占比，并丰富产品组合，开辟新的利润增长点。平板显示业务方面，合肥清溢引进平板显示用掩膜版光刻机，继续扩大 8.6 代高精度 TFT 用掩膜

版和 6 代高精度 AMOLED/LTPS/LTPO 用掩膜版产品的产能和技术能力，提升及增加半透膜（HTM）掩膜版产能，并积极推进 PSM 产品研发和设备选型，为后续进一步扩大市场占有率，为国内面板企业提供更可靠的供应链打下坚实基础。半导体业务方面，清溢微将继续拓展半导体芯片用掩膜版业务，引进半导体芯片用掩膜版检查等配套设备，持续提高半导体芯片用掩膜版的产能，并在佛山清溢微开展 130nm-65nm 半导体芯片用掩膜版的产品研发和 28nm 半导体芯片所需的掩膜版工艺开发规划。

二、持续回报投资者，共享公司发展红利

公司切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制，给予投资者持续稳定的合理回报。2024 年 6 月 28 日，公司向全体股东发放了 2023 年度现金红利，每 10 股派发现金红利人民币 1.60 元（含税）。截至权益分派股权登记日，公司总股本 266,800,000 股，扣减回购专用证券账户中股份数 1,723,419 股后为 265,076,581 股，以此为基数计算合计派发现金红利人民币 42,412,252.96 元（含税）。2023 年度公司现金分红金额占归属于母公司所有者的净利润的 31.68%。

2024 年 2 月 16 日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将在未来适宜的时机全部用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额为不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）。回购价格为不超过 26.92 元/股（含）。回购实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。截至本行动方案披露日，公司回购方案已实施完毕，累计回购公司股份 1,723,419 股，支付的资金总额为人民币 30,007,563.78 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十届董事会第十次会议，同意公司 2024 年度拟以 2023 年度向特定对象发行 A 股股票后的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.70 元（含税）。截至本年度报告披露日，公司总股本 314,800,000 股，其中 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 48,000,000 股正在办理股份登记及上市过程中，扣减回购专用证券账户中股份数 1,723,419 股后为 313,076,581 股，以此为基数计算合计拟派发现金红利

人民币 53,223,018.77 元（含税），占公司 2024 年度归属于母公司所有者的净利润的 30.94%。

2025 年，公司将根据所处行业状况，结合公司实际业务情况、自身盈利水平、现金流状况以及未来发展规划等因素综合考量，确定具体的利润分配形式及比例，在现金流量充裕且盈利状况良好的情况下，优先选择现金分红，切实回报股东，增强市场信心。

三、深化技术创新，加强人才队伍建设

1、平板显示掩膜版、半导体芯片掩膜版技术进展

2024 年，公司研发投入达 5,433.85 万元，同比增长 11.00%，占营业收入比例 4.89%；公司申请国家发明专利 14 件，实用新型专利 23 件，软件著作权 6 件，投稿论文 1 篇；新获授权国家发明专利 3 件，实用新型专利 12 件，软件著作权 6 件，发表论文 1 篇。公司主要依靠自主研发，在生产实践中不断完善和提高工艺技术水平。2024 年，公司增加了 18 项核心工艺技术，现共拥有 86 项核心工艺技术。主要研发项目进展情况如下：

（1）设备改造项目已完成光刻机 1615 DC 功能量产导入，大尺寸高精度掩膜版换 PIN 机器人改造项目，8.5G CF 产品精密装卸系统项目，以及 VPG1200 制作 813x1379MetalMask。

（2）工艺开发项目 4.5G HTM CF MASK（PS 层）产品开发项目进入试产阶段，已完成 PSM 掩膜版工艺开发，以及 IC 光罩 CD 精度提升到 130nm 产品工艺开发等项目。

（3）正在开发阶段的研发项目包括 LMM150 型 CD 测量机研发项目、大尺寸 MASK 上下版转运台车、涂胶线增加 98155 尺寸改造等项目。

公司研发项目提升了 6 代高精度 AMOLED/LTPS、平板显示等高精度掩膜版、FMM OLED 大尺寸高精度掩膜版、中高端半透膜掩膜版（HTM）、触控 PSM 高精度掩膜版和半导体芯片掩膜版的技术能力。

2、人才队伍建设

2024 年，为了进一步完善公司治理结构，健全激励机制，增强管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，公司持续推进核心岗位人才梯队建设，进一步优化多元化的短中长期激励计划。

2025 年，公司将聚焦上下游产业升级需求，深化掩膜版技术在半导体芯片与平板显示应用领域的技术布局，提高技术成果向新产品转化的效率，形成新的利润增长点。同时，持续优化人才结构，以现有人才为基础，完善员工职业发展规划，为员工提供多种职业发展机会（“管、工、技”三条通道），创造员工成长和发展的职业空间，同时择优引进具有较高素质的、急需的各类专业人才。

四、丰富投资者沟通渠道，加强与投资者的沟通交流

2024 年，公司认真贯彻保护投资者利益的要求，重视投资者关系管理，根据公司《投资者关系管理制度》从各个维度开展了投资者关系管理和维护工作。通过业绩说明会、机构调研会议、投资者热线电话及上证 E 互动平台等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流。

2025 年，公司将至少举办 3 次业绩说明会，就投资者关心的各类问题在合规范围内进行详细解答，同时将通过积极开展投资者调研活动，邀请投资者通过线上或线下活动与公司管理层进行深入沟通交流，增强投资者对公司的信任感和认同感。同时，公司将进一步优化与中小投资者的沟通渠道，积极利用上证 e 互动平台、专门设立的投资者关系邮箱及投资者专线等多元化方式，确保信息传递的及时、准确与全面。

五、优化公司治理体系，坚持规范运作

2024 年，公司进一步优化公司治理体系，建立健全管理机制，先后修订了《对外投资管理制度》《薪酬管理制度》《董事长工作制度》《信息披露暂缓及豁免管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等制度，并制定了《会计师事务所选聘制度》《舆情管理制度》，持续优化公司治理体系。2024 年 5 月，公司顺利完成了第十届董事会、监事会及董事会各专门委员会的换届工作。同时完成了董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及召集人、监事会主席的选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任。

2025 年，公司将继续强化董事、监事及高级管理人员等“关键少数”合规意识，提升“关键少数”履职能力。积极组织公司董监高参加监管机构组织的线上、线下培训，此外，相关部门将及时向董监高传递资本市场新规及监管动态，确保董监高及时了解最新法律法规，持续提升公司的治理水平和规范运作能力。

六、多举措拓宽公司融资渠道，为公司持续扩张奠定坚实基础

2024年8月9日，公司2023年度向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所受理，公司再融资项目稳步推进；2025年2月21日公司2023年度向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所审核通过；2025年4月9日公司2023年度向特定对象发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复；截至本行动方案披露日，公司已完成向特定对象发行工作。本次募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务展开，项目实施有助于提高公司高精度掩膜版产能，实现更高制程节点的高端半导体掩膜版的开发及产业化，满足下游市场日益扩大的需求，确保产品交付的及时性。同时募集资金到位进一步增强了公司的竞争实力，巩固公司的竞争优势及行业地位，后续公司将多举措拓宽融资渠道，保障公司发展。

2025年，公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，不断提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理，切实履行上市公司责任和义务，回馈投资者。

本次行动方案系基于目前公司的实际情况制定，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

深圳清溢光电股份有限公司董事会

2025年4月28日